

メカトロニクス製品

FOUP ロードポート 新機種の販売開始について

- ・次世代の直径 450mm ウェハ対応の高性能新機種と、300mm ウェハ用の価格競争力を高めた新機種を開発、販売

2012年7月3日

TDK 株式会社（社長：上釜 健宏）は、半導体製造装置向けに、2種類の FOUP ロードポート（品名：「TAS450 Type A2」および「TAS300 Type J1」）を開発し、2012年7月より発売開始することを発表します。

最先端の半導体デバイス製造過程では高水準のクリーン環境が不可欠ですが、そのためには大規模な空気清浄装置など巨額の設備投資が必要となります。このような設備投資を抑えるために近年は完全密閉したポッド（FOUP）に半導体基板（ウェハ）を格納し、半導体製造装置間を次々と自動搬送するシステムが主流となっています。

この度、当社が開発し、販売開始した2種類の新製品の概要は下記のとおりです。

1. TAS450 Type A2 について

次世代の直径 450mm サイズのウェハに対応し、業界最高レベルのパーティクル抑制を実現した新機種

主な特長

本製品は、半導体業界における次世代技術とされる大口径の直径 450mm のシリコンウェハを使用し、半導体を形成するプロセスの最新鋭搬送装置として開発したものです。

また、ウェハを出し入れする際に発生するパーティクル（ごみ）防止のため、開閉ドアを工夫して半導体装置内に外部からのパーティクルの進入を防ぎ、かつ本製品自身からのパーティクル発生を防ぐよう工夫しました。

2. TAS300 Type J1 について

業界最高レベルの軽量化・高速化を達成し価格競争力をも追求した新機種

主な特長

本製品は、半導体業界にて現行の製造で使われている直径 300mm のシリコンウェハ搬送装置ですが、価格競争力を高めた新機種として開発しました。2009年に市場投入しました Type H1 シリーズの後継機種であり、装置全体の軽量化をはかり、重量比で 1/2 としました。ウェハの出し入れをするドアの開閉スピードについては、H1 シリーズ比で約 40%速くすることが可能となりました。また、ドアについては、TAS450 Type A2 同様、パーティクルの発生と進入を防ぐよう工夫しました。

用語集

FOUP：半導体装置メーカーの業界団体である SEMI によって規格化された半導体ウェハの収納用ポッド。

主な用途

半導体製造装置間のシリコンウェハの自動搬送用

生産・販売計画

- ・生産拠点：秋田地区
- ・生産予定：(TAS450 Type A2) 50 台/月 (当初)
(TAS300 Type J1) 100 台/月 (当初)

- ・生産・販売開始：(TAS450 Type A2) 2012 年 7 月
(TAS300 Type J1) 2012 年 7 月

TDK 株式会社について

TDK 株式会社（本社：東京）は、各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で 1935 年に設立されました。

主な営業品目としては、各種受動部品をはじめ、HDD ヘッドやマグネットなどの磁気応用製品、電源、そしてエナジーデバイスやフラッシュメモリ応用デバイス、FA 関連機器等があります。アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、現在、情報通信機器、コンシューマー製品、自動車、産業電子機器の分野において、電子部品のリーディングカンパニーを目指しビジネスを展開しています。

2012 年 3 月期の売上は約 8,100 億円で、従業員総数は全世界で約 79,000 人です。

本文および関連する画像は http://www.tdk.co.jp/news_center/press/aah88700.htm からダウンロードできます。

報道関係者の問い合わせ先

担当	所属	電話番号	Email Address
大須賀	TDK 株式会社 広報部	+81 3 5201-7102	pr@jp.tdk.com